令和８年８月 20 日

関係各位

（一社）日本実装技術振興協会
会　長　　嶋田　勇三

第 240 定例講演会のお知らせ

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、日本実装技術振興協会の第 240 回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。
　今回は会場と WEB 会議システム（Zoom ウェビナー）を利用してのハイブリッド開催となります。
　ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

１．**開催日時**：令和８年９月 17 日（木）定例講演会 13：00～16：35
　　技術交流会 17：00～18：00

２．**開催方式**：ハイブリッド方式
　　【川崎市産業振興会館第３研修室＋WEB 会議システム「Zoom ウェビナー」】
　　（Zoom 参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）
　　川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 20
　　https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/

３．**プログラム**：**“HBM・チップレット実装を支える要素技術”**

⑴13:00～13:45 **プログラムテーマ①**	『ハイエンド半導体を支えるパネルレベルパッケージング技術と東レエンジニアリングのボンダーソリューション』 東レエンジニアリング（株）メカトロファインテック事業本部 第一事業部 営業部 営業１チーム シニアマネージャー竹内　裕之氏 **講演内容**：AI や HPC をはじめとするハイエンド半導体では、高密度実装と大面積化への対応が求められている。本講演では、これを支えるパネルレベルパッケージング（PLP）の技術動向と課題を整理するとともに、TCB による高精度を実現する同社のボンダーソリューションの特長について紹介する。
⑵13:45～14:30 **プログラムテーマ②**	『D2W 3D／ヘテロジニアス集積を高精度で実現するダイレクト・トランスファー・ボンディング』 タツモ（株）開発部 開発３課 DTB 首席研究員 佐野　一郎 氏 **講演内容**：先端半導体パッケージングにおいて、D2W による 3D／ヘテロジニアス集積はキーテクノロジーとなっている。本講演では、高精度な D2W 接合を実現する「ダイレクト・トランスファー・ボンディング（DTB）」技術について、50nm スケール精度達成のメカニズムや、近年の課題である極薄・反りチップに対する最新の接合評価結果を交えて解説する。あわせて、ファインピッチ・ハイブリッドボンディングの量産化に向けたプロセス課題や、将来の光電融合実装を見据えた展望についても言及する。
14:30～14:45	― 休　憩 ―
⑶14:45～15:30 **プログラムテーマ③**	『材料特性から見た低温はんだ接合技術と 3D 集積実装への適用可能性と課題』 （株）日本スペリア社 テクニカルサポートセンター 課長 赤岩 徹哉 氏 **講演内容**：はんだを用いたマイクロバンプ接合においては、すず（Sn）のマイグレーションやボイドの形成、金属間化合物（IMC）成長など、エレクトロマイグレーション（EM）に起因する信頼性課題の懸念がある。本講演では、低温実装による熱負荷低減が期待される Sn-Bi 系はんだ材料に着目し、材料物性および EM に関する実験知見を紹介する。さらに、独自に実施した EM 試験結果を基に、ビスマス（Bi）偏析や IMC 成長、組織変化ならびに HBM 向け接合材料としての適用可能性と課題について考察する。
⑷15:30～16:15 **プログラムテーマ④**	『高付加価値パッケージングを実現するソルダーレジストとその関連材料』 太陽インキ製造（株）ビジネスディベロップメント部 市場開発課・リーダー 角谷　武徳 氏 **講演内容**：HBM・チップレット実装に求められる高密度配線・高信頼性に対応した高付加価値パッケージングの実現を目的として、ソルダーレジストの概要を示すとともに、その要素技術および周

	辺材料の役割と特徴を整理し、同社の最新ソリューションを体系的に紹介する。
⑸16:15～16:35	『ディスペンサによるマイクロ・ダム形成とキャビティ内ハンダペースト塗布技術の紹介』 （株）エンジニアリング・ラボ 執行役員営業部 部長 小瀧 健一 氏 **講演内容**：同社の高粘度微細塗を実現した Twin-airⅡディスペンサの最新アプリケーションとして、①高密度実装基板へ高アスペクト比のマイクロダム形成を実現した技術，②多層基板上のキャビティ構造内部のパッドに、ハンダペーストの微小塗布を行う技術，の紹介を行う。
17:00～18:00	ー 技 術 交 流 会 ー 産業振興会館２階「カフェサウダージ」にて

４．参加費

会　員：無料　企業正会員は１社３名まで（Web 会議特例：３名を超える参加者については事務局に問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1 登録 1 名様のご利用でお申込みください。

会員外：22000 円／人（不課税）（お申し込み後，請求書をお送りします）

５．参加申し込み

会　員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mail にてお申し込みいただけますようお願いします。

※今回、会場と Zoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム（https://www.j-jisso.org/p/contact.html）より「お問い合わせ内容」の項目に「第 240 回定例講演会参加希望」と参加方式（会場もしくは Zoom）をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。お申し込み後、折り返しご連絡をいたします。

申込締切日：令和８年９月８日（火）

※講演２日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようにお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、当会ホームページの会員のページ（https://www.j-jisso.org/member/）に講演日までにアップいたします。ID と PW が必要ですので講演日前までにご確認ください（企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい）。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局
URL：http://www.j-jisso.org（HP 右上の「お問い合わせ」からご連絡下さい）